



kingston.com/epop

ePoP

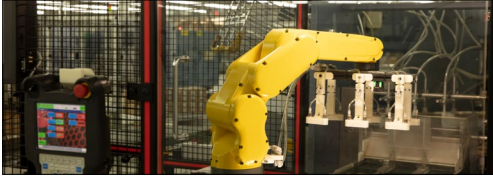
ウェアラブル向け組込み POP (Package-on-Package) メモリ

Kingston 製 ePoP は、eMMC (Embedded MultiMedia Card) ストレージと LPDDR (Low-Power Double Data Rate) DRAM を POP (Package-on-Package) ソリューションに組み合わせた高集積 JEDEC 規格コンポーネントを提供します。ePoP は、対応するホスト SoC (System-on-a-Chip) の上に直接取り付けられ、プリント回路基板 (PCB) のスペースを節約できるため、パフォーマンスが最適化されます。ePoP は、ウェアラブルなどのスペースに制約のあるアプリケーションに最適なソリューションです。

主な特長

- ePoP は、ホスト SoC の上に直接取り付けられるため、ウェアラブルなどのスペースに制約のあるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
- 省電力 DRAM と最適化されたストレージファームウェアによって、消費電力を削減する一方で、バッテリー式のウェアラブルアプリケーションに必要な高パフォーマンスを提供します。
- システム設計を簡素化し、商品化と品質検証の期間を短縮します。
- パフォーマンス、電力、寿命などアプリケーション要件に合わせて複数のファームウェア構成を利用できます。

市場セグメント



IoT



ウェアラブル



AR (拡張現実) /VR (仮想現実) デバイス

EPoP の製品番号と仕様

LPDDR4x ベースの ePoP

部品番号	容量		説明		パッケージ	FBGA	動作温度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
64EP16-M4MTB9W	64	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.6	144	-25°C ~ +85°C
64EP32-M4NTB9W	64	32	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.65	144	-25°C ~ +85°C

LPDDR5x ベースの ePoP

部品番号	容量		説明		パッケージ	FBGA	動作温度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
64EP16-M5ATB9W	64	16	5.1	LPDDR5x	8x9.5x0.58	201	-25°C ~ +85°C
64EP32-M5BTB9G	64	32	5.1	LPDDR5x	8x9.5x0.65	201	-25°C ~ +85°C
64EP32-M5BTB9M	64	32	5.1	LPDDR5x	8x9.5x0.7	201	-25°C ~ +85°C